# 236 純銅単結晶の塑性変形におよぼす亜粒界の影響

## 熊本工業大学

# 正 三浦 精

## 1. はじめに

金属結晶の主要な変形機構である転位の活動は結晶内に存在する不純物、林転位、結晶粒界や亜粒界等によって大きな影響をうける。このため現在までに、すべり線観察、エッチビット法や電顕法によって、その様々な影響を解明する試みがなされてきた。これらの手段のうち、結晶内部を直接観察するのに適しているのは透過電顕法であるが、それには薄膜内の転位挙動がバルク材中の挙動と必ずしも一致しない等の問題がある。一方エッチビット法は、結晶内部の転位を直接観察出来ないが、広範囲にわたり転位の挙動を微視的に観察することが出来る。

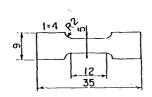
Livingstor[1]とYoung [2] が銅についての腐食液を見出して以来、北島ら[3] が銅単結晶の降伏応力と転位についての挙動を詳細にエッチビット法を用いて検討した報告など、銅単結晶の転位挙動には数多くの報告がある。彼らの研究により、亜粒界の存在が降伏現象等についても多大の影響を与えることが明らかになったが、その主目的は個々の転位の運動や増殖の機構を明らかにすることであったため、巨視的な降伏応力と結晶の平均亜粒界の広範囲での関係はあまり明らかにされていない。

本研究においては引張軸方位 [253] を有する単結晶を引張変形エッチビット法を用い平均亜粒界径を測定し、降伏応力および変形応力との関係をもとめ、 Hall-Petch式との比較検討をおこなった

### 2。実験方法

供試材として99.998%の純度のCuを真空中で溶解し、ブリッジマン法により14x14 mm 横断面をもつ角柱単結晶を作成した。溶解温度は1473K 真空度は4×10 mmFg以下であった。これを放電加工により1組の平行な(111) 面を有する厚さ4 mmの単結晶板を切り出し、これより長軸方向方位が[253]の角柱単結晶(4×5×60m)を切り出し、種結晶とし、この種結晶の転位密度を減ずるために1103-1304Kに温度を周期的に変化させる繰り返し焼鈍を真空中で約200hr行った後カーボンモールドに設置し種付けを行い、単結晶板をブリッジマン法によって作製した。これらの単結晶板よりFig. 1に示すような寸法形状の

単結晶板を放電加工により切り出した。放電加工による表面層を除去する為にエメリー湿式研磨紙で#1200まで機械研磨しその加工層を除去する為H3PO480%C2H5OH20%溶液中で8-10hr電解研磨を行った。この様にして作製した試片は転位密度が高くエッチビット観察には不適当であったので転位密度をさげる為、種結晶で行ったと同様繰り返し焼鈍、電解研磨を行い実験に供した。試片の軸方位をFg2に示す。



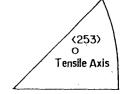


Fig. 1 Shape and dimensions of the single crystal.

Fig. 2 The tensile sxis of the single crystals

同一試片を用いて数回の引張り試験を行い、変形の進行による転位密度をエッチピット法により測定した。腐食液はYoung液[2]を改良した丸川B液[4] (HCI 140cc, HBr 3cc, Fest 2C) 27gr, Ft2O 150cc) の希釈液である。

#### 3 実験結果と考察

以上のようにして得られた単結晶試片S1一S5施した 熱処理及びその結果得られた各試片の亜粒界内の平均転 位密度及び平均亜粒界径をTable1に示した。これらは エッチピット法を用いて測定したものである。

Table 1.

The mean diameter and the initial dislocation density of the single crystal specimens annealed for valious times.

Speaimen Number		Anneali	.ng	Dislocation Density	Diameter of Sub-grain pm	
		Constant (hr)	Cyclic (hr)	cm³/cm		
S 1		40	200	1.86×10 <sup>5</sup>	75	
S 2	2	40	50	2.01×10 <sup>5</sup>	67	
s :	,	40	25	2.31×10 <sup>5</sup>	52	
s 4		40	200	9.31×10 <sup>4</sup>	105	
s s	5	40	120	4.20×10 <sup>4</sup>	164	

実験に用いた 5 個の単結晶試片 S 1 - S 5 の応力ーひずみ曲線を求め、これより各試片の伸び 0.1% 0.5%,1.0 %における公称応力  $\sigma$   $0.1,\sigma$  0.5  $\sigma$  1.0 また各試片の臨界せん断応力  $\tau$  0.3 よび主すべり系のせん断応力  $\tau$  0.5、 $\tau$  0.5  $\tau$  0

Table 2

Speaknen Number	O im.	<b>G</b> os	σιο	You Sugar To pural	Flow Street		Diamier of	
					Tos	720	Bub-grain (µm)	q.1\s
_S3	3.1	3.9	5.1	1.16	135	176	50	0.141
S2	2.5	3.4	4.2	102	120	148	65	0.124
S1	17	3.0	4.4	0.83	0.89	140	75	0.115
S4	17	3.0	5.2	0.70	0.85	154	105	0.098
S5	13	2.3	3.3	0.54	0.66	111	165	0.078

Table 2 より求められた結果をHall-Petchの関係

式  $\tau_y = \tau_1 + k_y d$ (1)

に従って整理するとFig。3となる。ここでTy は降伏応力、 T 1およびkyは定数、dは平均亜 粒界である。 T oおよび T o.5 については直線関係 が得られるが、 て 2.0 についてはその関係はえられ ない。 T o および T o.5 と 平均 亜 粒 界 直径、 $\mathcal{A}$  ( $\mu$ ) の関係は

 $\tau_0 = -0.27 + 10.04 d$ (Mpa) (2)-1/2

 $\tau$  o.5=-0. 23+10. 98d (Mpa) (3) となる。MeckingとBulian[5], は5NのCuの方

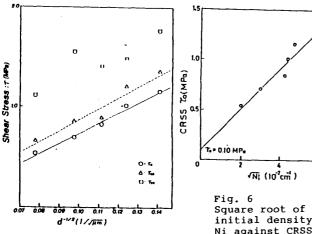
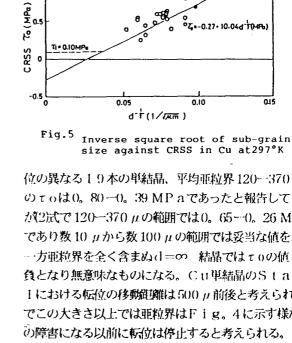
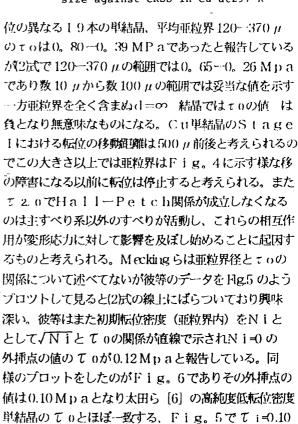


Fig. 3 Inverse square root of sub-grain size against shear stress at 297°K



15

ιο



0.27 • 10.04d T(MPb)

**S4** 100 µ Shear Strain:  $\gamma = 0.5$  (%) Shear Strain:  $\gamma = 2.0 (\%)$ 

Fig.4 Dislocation etch-pits distribution in S4 -250-

文献

距離のデータと矛盾しない。

Mpaとして平行線をひくとそれに対応する亜粒界径

は770 µとなり北島ら [6] の求めた転位の平均移動

Critical [1]J.D.Livingston: J.Appl.Phys., 31 (1960) ,1072.

> [2]F.W.Young Jr.: J.Appl.Hys.,32 (1961) ,1815.

> [3] 北島貞吉:日本金属学会誌:B (1974) , 105.

[4] K.Marukawa J.Phys.Soc. Japan, 22 (1962) ,449.

[5] H.Mecking and G.B.diiian: Acta Met,24 (1976) ,249.

[6] 太田道雄、北島貞吉、海江田弘也: 日本金属学会誌:36(1972)、 617.